

光大证券股份有限公司

关于苏州纳芯微电子股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	上市公司：苏州纳芯微电子股份有限公司
保荐代表人姓名：江嵘	联系方式：021-52523200
	联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号
保荐代表人姓名：陆佳杭	联系方式：021-52523200
	联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号

重大事项提示

2024 年度，公司实现营业收入 196,027.42 万元，同比增长 49.53%，但受整体宏观经济以及市场竞争加剧等多重因素的影响，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,677.81 万元，同比下降 16.19%。针对前述公司业绩亏损的情况，本保荐机构提醒投资者予以关注。

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕427 号”批准，苏州纳芯微电子股份有限公司（简称“公司”或“纳芯微”）于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后在上海证券交易所科创板上市。公司本次向社会公开发行人民币普通股 2,526.60 万股，每股发行价格为人民币 230.00 元，募集资金总额为 581,118.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 22,993.34 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 558,124.66 万元。本次公开发行股票于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市。光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由光大证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，光大证券出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	项目	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	2024 年度，保荐机构通过日常沟通、不定期回访、现场检查等方式，对公司开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2024 年度，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2024 年度，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员，2024 年度，公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	公司章程、三会议事规则等制度符合相关法规要求，2024 年度，公司有效执行了相关治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	公司内控制度符合相关法规要求，2024 年度，公司有效执行了相关内控制度。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况”。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审	详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况”。

序号	项目	持续督导工作情况
	阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况”。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2024年6月24日，上海证券交易所就公司业绩预告披露事项对公司及相关人员予以口头警示。保荐机构已根据口头警示相关违规类型和警示事项，督促公司按照《公司法》《证券法》等相关规定持续做好规范运作和信息披露。 2024年7月2日，江苏证监局就公司拟收购上海麦歌恩电子股份有限公司部分股份及上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理合伙（有限合伙）部分财产份额等事项出具了《江苏证监局关于苏州纳芯微电子股份有限公司的监管关注函》（苏证监函〔2024〕606号），保荐机构切实履行持续督导职责，督导公司持续做好规范运作和信息披露，并协同公司、独立董事及本次收购财务顾问针对本次收购事项进行沟通，对关注函涉及事项发表意见。 2024年8月1日，江苏证监局就公司业绩预告、业绩快报披露事项出具了《江苏证监局关于苏州纳芯微电子股份有限公司的监管关注函》（苏证监函〔2024〕722号），保荐机构切实履行持续督导职责，评估本次关注函事项对公司的影响，并督导公司后续持续做好规范运作和信息披露。
13	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海	2024年度，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。

序号	项目	持续督导工作情况
	证券交易所报告。	
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2024 年度，公司未出现该等事项。
15	在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2024 年度，公司未出现该等事项。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应当有一人参加现场检查。	保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。保荐机构于 2024 年 9 月对上市公司进行了现场检查，负责该项目的两名保荐代表人参加了现场检查。
17	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内，对上市公司进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2024 年度，公司未出现该等事项。
18	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	保荐机构对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。2024 年度公司存在使用募集资金理财产品专用结算账户永久补充流动资金的情形，具体问题及整改

序号	项目	持续督导工作情况
		情况详见“十、募集资金的使用情况及是否合规”。

二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

光大证券持续督导人员对公司 2024 年度的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括年度报告、半年度报告、业绩快报、业绩预告、股东大会、董事会和监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，纳芯微严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024 年度公司存在使用募集资金理财产品专用结算账户永久补充流动资金的情形，具体问题及整改情况详见“十、募集资金的使用情况及是否合规”。

四、重大风险事项

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

本期归属于上市公司股东的净利润为-40,287.82 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,677.81 万元；本期归属上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是因为：1）受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，公司产品售价承压，毛利率较上年同期有所下降；2）公司在研发投入、市场开拓、供应链体系建设、产品质量管理、人才建设等多方面资源投入的积累，虽然有助于公司的长期发展和市场竞争力提升，但在短期内增加了公司的销售费用、管理费用和研发费用；3）公司基于谨慎性考虑，对预计存在较大可能发生减值损失的资产计提了减值准备，使得信用减值损失和资产减值损失较上年同期增长较大。

公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。如果后期下游终端市场需求持续下降、市场竞争加剧、宏观景气度下行、

国家产业政策变化、公司客户拓展情况不及预期等情形，公司业绩可能存在持续下滑或亏损的风险。

（二）核心竞争力风险

1、持续技术创新能力不足的风险

公司主要从事模拟芯片的研发、设计与销售，所属行业为集成电路设计行业。集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，持续技术创新是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。随着市场竞争的加剧以及终端客户产品应用场景的不断丰富，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断优化现有产品并研发新技术、新产品，从而保持技术创新性和产品竞争力。

如果公司不能对未来市场的发展趋势进行准确的判断，保持核心技术优势并推出具有竞争力的新产品，而竞争对手推出的新技术、新产品满足市场需要，则公司将逐渐丧失市场竞争力，对公司未来持续发展经营造成不利影响。

2、研发人才紧缺及流失的风险

集成电路设计企业具有技术密集的特点，研发人员是其保持技术发展和产品优势的核心要素。随着行业规模的不断增长，集成电路设计企业对于核心技术人才的竞争日趋激烈。如果公司不能有效稳定公司核心技术团队，提供有市场竞争力的待遇，并保持对新人才的引进和培养，那么可能出现人才流失或紧缺的风险，将对公司的持续研发能力造成不利影响。

3、核心技术泄密风险

经过专业研发团队多年的积累，公司在传感器、信号链、电源与驱动、第三代功率半导体等五大领域形成了多项核心技术。公司与核心技术人员签署了保密协议，并就核心技术形成的知识产权申请了专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等。鉴于公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，生产过程中也需向供应商提供相关数据、芯片版图，如果出现核心技术人员流失或供应商保管不当等情况，可能产生核心技术泄密或被他人盗用的风险。

（三）经营风险

1、委外加工及供应商集中度较高的风险

报告期内，公司主要采用集成电路设计行业常用的 Fabless 模式，晶圆制造、芯片封装和芯片测试均由委外厂商完成。受限于技术水平、资本规模等因素，全球范围内符合公司技术、供货量、代工成本等要求的晶圆和封装测试供应商数量较少，公司晶圆制造、封装测试的代工服务主要委托业内知名厂商进行，采购集中度较高。如果公司的主要供应商业务经营发生重大变化、产能受限或合作关系变化，可能导致供应商不能足量及时出货，或导致公司采购成本增加，可能对公司盈利能力和经营业绩产生不利影响。

2、经营规模扩大带来的管理风险

随着公司业务持续发展和募投项目的实施，公司的收入和资产规模会进一步扩大，产品种类也将增多，员工人数相应增加，这将对公司的经营管理、质量管控、资源整合、市场开拓、内部控制、财务规范等方面提出更高的要求。如果公司不能随业务规模扩大及时优化及提升组织模式、管理制度和管理水平，将会一定程度上面临经营规模扩大带来的管理风险，进而对盈利能力造成不利影响。

（四）财务风险

1、存货跌价风险

随着公司业务规模的不断扩大，存货规模随之上升，如果未来市场需求发生变化或与公司预测情况差异较大，或者公司不能随着存货的增加优化库存管理水平，则可能导致产品滞销、存货积压，从而需要增加计提存货跌价准备，对公司经营业绩产生不利影响。

2、毛利率波动风险

报告期内，公司各类产品毛利率及综合毛利率均存在一定程度的波动。公司产品毛利率水平主要受产品售价波动、产品结构变化等因素影响所致。如果未来出现公司不能保持技术优势、市场竞争加剧等原因而导致销售价格下降，或采购价格上升导致成本上升，可能导致毛利率下降，对公司的盈利能力带来一定风险。

3、汇率波动风险

随着公司全球多元化战略的推进实施，以外币结算的采购和销售业务比重不断上升。汇率的变动将影响以外币计价的资产、负债及境外实体的价值，并间接引起公司一定期间收益或现金流量的变化。随着汇率市场化改革的深入，人民币与其它可兑换货币之间的汇率波动较大，存在外汇结算过程中的汇率波动风险。

（五）行业风险

公司主要产品的竞争对手为成立时间早、营收规模大且品牌影响力较高的国外龙头企业，如迈来芯（Melexis）、瑞萨电子（Renesas）、英飞凌（Infineon）、亚德诺（ADI）和德州仪器（TI）等公司。公司在营收规模、产品丰富度和技术积累上与上述公司仍有一定差距，如果未来公司不能保持在细分产品领域的技术和性价比优势，不能及时推出在功能、性能、可靠性等方面更为契合市场需求的产品，则会在客户开发过程中面临更为激烈的竞争，存在被上述国外厂商利用其先发优势挤压公司市场份额的风险。

（六）宏观环境风险

1、宏观环境及行业风险

公司芯片产品应用领域非常广泛，涵盖了汽车电子、工业、光伏储能、电机控制、通讯、家电、医疗、消费等众多行业，因此公司业务发展不可避免会受宏观经济波动的影响。如果宏观经济形势不及预期或公司下游细分市场出现较大不利变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

2、国际贸易摩擦风险

报告期内，公司终端客户包括诸多境内外知名企业，如果国际贸易摩擦进一步加剧，可能导致公司重大客户采购受到限制，进而影响到公司向其销售各类产品，对公司的经营业绩产生一定的不利影响。同时，报告期内公司的晶圆代工、封装测试主要向国内外的头部供应商采购，上述供应商可能受到国际贸易政策的影响，进而影响到其对公司晶圆、封装测试的供应，从而对公司生产经营产生一定不利影响。

（七）股权激励导致股份支付金额持续较大的风险

在公司的快速发展阶段，为吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司设立了多个员工持股平台，进行了多次股权激励，导致公司股份支付费用大幅增加。尽管股权激励有助于稳定人员结构以及留住核心人才，但相关的股份支付费用将会对公司经营业绩产生一定影响。

五、重大违规事项

无。

六、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2024 年度	2023 年度	增减幅度（%）
营业收入	196,027.42	131,092.72	49.53
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	194,666.54	130,379.02	49.31
归属于上市公司股东的净利润	-40,287.82	-30,533.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,677.81	-39,312.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,505.33	-13,940.98	不适用
主要财务数据	2024 年末	2023 年末	增减幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产	594,234.42	620,650.23	-4.26
总资产	767,357.59	715,631.40	7.23
主要财务指标	2024 年度	2023 年度	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	-2.86	-2.15	不适用
稀释每股收益（元/股）	-2.85	-2.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-3.25	-2.77	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-6.65	-4.79	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.53	-6.17	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	27.55	39.79	减少12.24个百分点

本报告期内，部分财务数据及指标的变动原因如下：

1、报告期内，公司实现营业收入 196,027.42 万元，同比增长 49.53%。公司

从一季度营收 36,248.16 万元到四季度营收 59,429.18 万元，单季度营业收入逐季递增，整体经营业绩处于快速增长态势，尽管三季度环比二季度增长幅度相对较小，但公司在四季度营收又恢复了较大幅度增长，长期增长趋势明显。随着下游汽车电子领域需求稳健增长，新能源汽车渗透率持续提升，公司汽车电子相关产品持续放量，公司 2024 年度营收再创新高。此外，上海麦歌恩电子股份有限公司（以下简称“麦歌恩”）磁传感器产品销售表现出色，麦歌恩于 2024 年 11 月-12 月期间被纳入公司合并报表范围，并在两个月内实现营业收入 7,318.72 万元。

2、本期归属于上市公司股东的净利润为-40,287.82 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,677.81 万元；本期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是因为：1) 受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，公司产品售价承压，毛利率较上年同期有所下降；2)公司在研发投入、市场开拓、供应链体系建设、产品质量管理、人才建设等多方面资源投入的积累，虽然有助于公司的长期发展和市场竞争力提升，但在短期内增加了公司的销售费用、管理费用和研发费用；3)公司基于谨慎性考虑，对预计存在较大可能发生减值损失的资产计提了减值准备，使得信用减值损失和资产减值损失较上年同期增长较大。

3、本期经营活动产生的现金流量净额为 9,505.33 万元，实现回正，主要原因在于本期客户销售回款显著增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 49,302.03 万元，同比增长 33.07%；同时，随着前期库存消耗，本期备货现金流出增长趋缓，两者同时影响下使得经营活动产生的现金流量净额回正。

4、本期研发投入占营业收入的比例为 27.55%，同比减少 12.24 个百分点，营业收入的增长使得研发投入占比下降；同时，本期大额股份支付费用冲回，剔除股份支付费用后的研发费用较上年同期增长 44.57%，主要为研发人员的增加所致。

七、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、核心技术及研发优势

（1）核心技术储备丰富

公司作为集成电路设计企业，拥有专业的模拟芯片研发能力，并深度参与后续封装框架和测试软件的搭建，建立了从芯片定义到设计及交付的完整管控体系。凭借多年的研发积累，公司以信号链技术为基础，在模拟及混合信号领域开展了自主研发工作，并在传感器、信号链、电源与驱动、第三代功率半导体等五大领域形成了多项核心技术，广泛应用于各类自研模拟及混合信号芯片产品中，主要产品的核心技术指标达到或优于国际竞品水平。

（2）非标产品设计能力突出

为了满足下游客户的应用需求，公司可根据客户的参数条件定制开发相应产品，如集成式压力传感器的量程、封装、接口皆可定制。此外，公司可应客户的需求设计芯片、提供定制化封装和测试方法，并深度参与到客户的产品验证、测试等工序的设计和搭建，为客户提供从芯片设计、产品适配到批量标定校准等多环节服务。凭借自身对行业的理解和技术积累，公司帮助多家下游客户成功进入目标汽车厂商的合格供应体系。

2、质量管控优势

公司高度重视产品质量的可靠性，始终坚持高标准的质量要求。公司以“可靠可信赖”的质量方针为根本遵循，从产品的研发到生产的过程中，坚持严格的质量管控，为客户提供稳定可靠的产品；以客户满意为宗旨，坚守对客户承诺，持续不断的改进产品和服务，成为客户可信赖的公司。公司秉承着“质量从设计开始并贯穿整个产品生命周期”的质量管理理念，构建了全面质量管理体系，并通过组织能力建设以及流程体系 IT 化建设确保全面质量管理体系的落实和执行，持续不断地追求“零缺陷”的质量目标。尤其是车规方面，从跨部门协作组织、到符合车规产品的质量体系，符合车规标准的产品设计开发、符合车规标准的生产工艺管控、符合 AEC-Q 标准的可靠性认证等整个产品生命周期过程中构建了符合车规要求的质量管理体系，满足车规客户的要求。

3、产品品类优势

公司作为国内较早规模量产数字隔离芯片的企业，发展至今，公司隔离器件

品类非常齐全，并在标准数字隔离器上扩品开发了增强型隔离器等多种品类。报告期内公司推出了电压基准、栅极驱动、LED 驱动、供电电源 LDO、功率路径保护等多款信号链、电源管理产品。此外，公司集成式传感器芯片中的压力传感器芯片可覆盖从微压到中高压的全量程。传感器信号调理 ASIC 芯片已覆盖压力传感器、硅麦克风、加速度传感器、电流传感器、红外传感器等多种品类。公司围绕下游应用场景建立了丰富的产品品类，具有从消费级、工业级到车规级的产品覆盖能力。

4、客户资源优势

凭借过硬的技术研发实力以及优秀的产品口碑，公司取得了众多行业龙头标杆客户的认可。此外，公司拥有丰富的面向汽车前装市场模拟芯片产品定义、开发和量产经验。相较其他领域公司来说，汽车客户的认证周期长且测试严格，对产品的技术和质量要求更高，公司车规级芯片已在大量主流整车厂商/汽车一级供应商实现批量装车。获得行业标杆客户的认证也有利于公司在相同领域客户的商业拓展，进一步扩大领先优势。

5、供应链优势

在晶圆制造方面，公司已与主要供应商保持长期、稳定的合作关系。在芯片封装及测试方面，公司与主要封装测试供应商深度合作多年，已形成了稳定的封装测试工艺，并购入了专用测试设备交由部分测试厂商进行芯片测试，绑定了专属产能。同时，随着经营规模的快速增长，公司已自建封测工厂，将压力传感器及定制化产品自行封测，保证公司产能需求和控制成本，降低了行业产能波动对公司产品产量、供货周期的影响。

（二）核心竞争力变化情况

2024 年度，公司的核心竞争力未发生重大变化。

八、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度（%）
费用化研发投入	539,992,130.07	521,614,384.04	3.52
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	539,992,130.07	521,614,384.04	3.52
研发投入总额占营业收入比例（%）	27.55	39.79	减少 12.24 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

1、报告期内取得的研发成果

报告期内，公司新获得发明专利 31 项、实用新型专利 7 项、软件著作权 3 项、集成电路布图设计 17 项及境外知识产权 4 项，具体如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	44	31	229	112
实用新型专利	20	7	93	74
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	0	3	27	28
集成电路布图设计	22	17	189	188
境外知识产权	11	4	42	4
合计	97	62	581	407

注：上表含麦歌恩知识产权情况：麦歌恩本年新增知识产权项目申请 17 件；本年新增获得知识产权项目授权 25 件；累计申请知识产权项目 195 件；累计获得知识产权项目 173 件。

2、在研项目

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	处理器芯片研发	15,000	1,572.31	1,851.66	持续开发	开发汽车专用 SOC 处理器方向在用的汽车马达控制 SOC,汽车氛围灯和 Touch 方向以及汽车传感	国际领先	汽车电子执行器，汽车智能氛围灯和 TouchSense 以及汽车传感方向

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						方向针对性的开发一系列专用处理器		
2	低功耗 MEMS 麦克风信号调理芯片研发	4,000	331.8	976.46	持续开发	低功耗, 高 PSRR, 高 AOP/SNR 的数字麦克风 ASIC	国际领先	手机内高性能数字麦克风模组
3	高集成度专用 ASSP 芯片研发	11,000	1,524.38	8,974.31	持续开发	研发符合 AEC-Q100 标准的车规级电机控制器系列, 内置控制 MCU+驱动半桥以及集成功率管, 支持 BLDC, BDC, Stepper	国内领先	主要应用于新能源车热管理系统和车身管理系统
4	通用信号链 AFE 芯片的研发	9,000	2,391.26	2,391.26	持续开发	研发 40V 耐压, 400mA 输出能力, 带过流保护和预警的旋转变压器驱动运算放大器, 应用于新能源汽车的主驱电机系统中; 研发 80V 共模电压能力, CMRR 指标高达 120dB 以上的电流传感放大器, 应用于汽车车身和底盘系统以及 48V 通讯电源的输出监控系统中; 研发 40V 耐压的通用汽车级运算放大器;	国内领先	主要应用于新能源汽车主驱系统, 汽车车身底盘以及通讯电源系统中
5	高集成隔离电源芯片的研发	4,000	1,507.93	3,296.54	持续开发	开发高可靠性低 EMI 的隔离电源产品, EMI 达到工业 ClassB 的标准	国际领先	主要应用于工业控制、电源、电力电表
6	高性能高可靠性 I2C 接口芯片研发	600	100.53	450.47	持续开发	开发工业级和汽车级的 I ² C 接口类芯片, 补全产品系列	国内领先	主要应用于汽车电子领域和工业领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
7	高性能高可靠性的隔离采样芯片的研发	7,000	1,431.64	3,609.97	持续开发	开发工业级隔离模拟信号采样芯片，主要为高性价比隔离电压采样芯片研发	国际领先	主要应用于工业控制、电源、电力电表
8	新一代高压固态继电器芯片开发	1,000	179.18	179.18	持续开发	开发适用于汽车绝缘监测系统的高压固态继电器芯片，实现 1700V 和 600V 两个电压挡位，分别满足 800V 和 400V 的电池系统，采用非光耦的传输方式，提高了系统应用的长期可靠性	国际领先	汽车电子，工业储能
9	新一代工业和通讯类接口芯片研发	2,000	998.4	998.4	持续开发	开发符合工业级高可靠性的接口芯片，主要分为多点低压差分接口 MLVDS 芯片、隔离 485 芯片和隔离 CAN 接口芯片	国内领先	工业控制、通信设备等
10	新一代汽车级接口芯片研发	5,000	3,909.30	3,909.30	持续开发	开发满足 AEC-Q100 标准的高可靠性 LIN、CAN 等接口芯片，CAN 芯片需要满足 ISO11898 国际标准，支持 56V 的总线耐压，系统 ESD 达到 8kV	国内领先	汽车电子
11	新一代高性价比数字隔离芯片的研发	3,000	1,109.75	2,295.94	持续开发	研发高性价比数字隔离芯片	国际领先	主要应用于汽车电子领域、工业领域
12	车规级 LED 驱动研发	8,500	3,728.38	3,728.38	持续开发	开发汽车前灯应用场景一系列芯片，包含恒压输出芯片和恒流输出芯片，内部集成各	国内领先	汽车前灯

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						种错误检测，包含输入电压的欠压过压，LED 驱动输出开路短路等		
13	车规级开关电源研发	12,000	3,968.11	3,968.11	持续开发	开发车规级开关电源，包含升压 Boost,降压 Buck, 包含不同的输入输出电压和不同的输出电流能力等	国内领先	汽车智能座舱等
14	车规级高边开关研发	15,000	3,149.28	3,149.28	持续开发	开发汽车应用一系列高边开关，用于驱动阻性、容性和感性负载等	国内领先	车身域，智能座舱，前灯等各种小系统
15	步进马达驱动芯片研发	1,000	336.75	891.83	持续开发	开发车规级 32/64/128/256 细分步进马达驱动芯片系列，驱动电流达 1.5A 以上，内部集成电流检测，智能衰减模式，自带各种保护功能，如欠压，短路，负载检测等等	国内领先	汽车热管理，车灯等
16	车规高性能音频功放芯片研发	5,000	2,177.84	2,309.53	持续开发	开发车规中大功率 D 类音频功夫系列产品，整体性能达到国际厂商最新一代水平	国内领先	汽车影音娱乐系统，智能座舱，应急电话系统，发动机噪音模拟系统
17	第三代半导体栅极驱动芯片研发	1,500	642.91	846.92	持续开发	开发适用于氮化镓及碳化硅器件的专用栅极驱动芯片	国际领先	汽车激光雷达，数字电源，光伏等
18	多路高低边驱动芯片研发	2,000	778.94	1,366.29	持续开发	开发车规及工规级单路/双路/4 路/8 路低边，可配置高低边驱动芯片系列，RDSon 覆盖 90mohm 到 1mohm，集成负载	国内领先	新能源车车身电子，工业自动化

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						检测及各种保护功能		
19	高性价比隔离栅极驱动器的研发	6,000	2,091.43	4,200.19	持续开发	基于新工艺平台，开发耐压 30V+，单通道，半桥，智能隔离驱动产品系列。实现性能更优，成本更低，驱动电流覆盖 1A~15A，进一步提升抗干扰性能	国际领先	新能源车电源与电控
20	基于化合物半导体的功率器件研发	1,500	371.69	600.61	持续开发	开发车规与工规 650V，1200V，1700VSiCMOSFET 产品系列，涉及 TO247-3，TO247-4,TO263 等封装，全面覆盖新能源电源，热管理，光伏，数字电源的应用场景	国内领先	新能源车电源与热管理系统，光伏，数字电源
21	基于新工艺平台的非隔离驱动研发	3,000	889.17	1,698.88	持续开发	基于新工艺平台，开发 35V，120V，200V，600V，单通道，半桥非隔离驱动产品系列。实现性能更优，成本更低，驱动电流覆盖 1A~5A	国内领先	新能源车电源与电控，泛能源
22	多路预驱马达驱动芯片研发	3,000	1,609.61	1,609.61	持续开发	开发多路直流电机预驱芯片，覆盖 2 通道到 8 通道，集成各种诊断及保护功能	国内领先	车身电子，域控，底盘等
23	直流有刷马达驱动芯片研发	3,000	1,063.85	1,571.88	持续开发	开发车规及工规级集成功率 MOSFETH 桥驱动，3.5A~20A 驱动电流系列产品。多通道预驱芯片系列，集成负载诊	国内领先	车身电子及娱乐系统

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						断及各种保护功能		
24	多路半桥集成马达驱动芯片研发	3,000	1,286.17	1,286.17	持续开发	开发多路半桥集成直流电机驱动芯片，覆盖 2 通道到最高 12 通道	国内领先	车身电子，域控等
25	面向于泛能源和新能源汽车应用的硅基功率器件研发	1,000	335.26	570.74	持续开发	开发车规级 650V、750V、1200V，30A 至 280AIGBT 各等级单管产品，以及车规级 650V15A 至 70A 超级结功率 MOSFET 系列产品，全面覆盖新能源车电控，电源，热管理，光伏，储能等应用场景	国内领先	新能源车电控，电源与热管理系统，泛能源
26	汽车功能安全隔离驱动芯片研发	8,000	1,443.36	5,756.40	持续开发	开发符合汽车功能安全 ISO26262ASIL-D 认证及 AEC-100 标准的车规级智能隔离栅极驱动芯片，从设计，仿真，验证，生产制造全流程符合汽车功能安全流程要求，产品驱动电流达到+/-15A，集成多通道高精度 ADC，集成上电自检与诊断功能，同时适配 IGBT 与 SiCMOSFET，多模式，多功能的保护功能	国内领先，CMTI 指标国际领先	主要应用于新能源车电控
27	适用氮化镓功率器件专用芯片的研发	3,000	605.74	1,549.36	持续开发	开发适配 E-ModeGaN FET 专用驱动芯片及合封 PowerStage 产品，集成 SR 控	国内领先	数字电源类，光伏逆变器等

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						制及驱动电压调节功能，适配各种厂商 GaNFET		
28	同步整流功率级芯片研发	2,000	260.04	570.89	持续开发	开发适用于 AI 服务器板卡 Vcore 供电新型拓扑的同步整流功率级芯片，实现高达 70A/CH 电流能力，集成故障回报，短路保护，过温保护等各种保护功能	国际领先	AI 服务器电源
29	音频功放芯片研发	8,000	971.59	4,681.35	持续开发	开发符合车规的音频功放芯片，主要分为四通道，两通道和单通道。输入方式包含模拟与数字，其中 4 通道最高功率需要达到 4*150W，每个通道峰值电流会到 10A，此外由于功率比较高，需要使用粗铜线工艺与大散热封装	国内领先	主要用于车载多媒体
30	高集成度传感器调理芯片研发	3,000	8.97	54.03	持续开发	针对不同的传感器类型，开发完成一系列专用的高性能传感器信号调理芯片	国际领先	汽车动力系统/热管理系统/制动系统，工业控制，光伏等应用
31	高精度温/湿度传感器芯片研发	2,600	995.5	2,265.71	持续开发	研发集成式温湿度传感器芯片，湿度精度可达 + -3%，LGA 封装和 DFN 两种封装；DFN 封装应用在工业，汽车领域；LGA 封装应用在消费领域，IoT 市场	国内领先	主要应用于工业领域，汽车电子领域，消费和 IoT 领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
32	高可靠性压力传感器研发	7,000	3,149.15	6,387.36	持续开发	通过小尺寸、小量程、低噪声 MEMS 芯片+传感器信号调理 ASIC 芯片，低应力集成封装技术，实现差压传感器的 4~100kPa 量程和绝压传感器的 100~400kPa 量程，全温域可达精度 1%	国内领先	主要应用于汽车电子领域、工业领域，医疗领域
33	基于霍尔/磁阻效应的磁性传感器芯片研发	16,500	4,266.91	8,302.65	持续开发	研发符合 AEC-Q100 标准的车规级磁传感器芯片，支持 -24V~28V 过压反压保护，达到 1% 的绝对精度，实现国产芯片在磁传感器领域中高端应用上的突破；其中包括磁性位移，电流，速度等传感器	国内领先	主要应用于汽车电子领域、工业领域
34	汽车旋转变压器驱动芯片	500	436.18	436.18	量产阶段	开发车规级，高压 40V，5M 带宽，400mA 大电流输出，单/双路运算放大器	国内领先	旋转变压器驱动、激光雷达
35	锂电池用过流保护器件研发	1,000	79.37	79.37	持续开发	开发出特色工艺，并在工艺基础上开发多款低压平面 MOS 管，覆盖 1 豪欧到 33 豪欧	国际领先	手机锂电池保护，智能手表，充电宝等锂电应用场景
36	下一代 BCDu2 技术开发项目	2,200	263.52	263.52	持续开发	新一代高性能 BCDu2 技术开发，为各类商用、车用模拟芯片提供最佳的工艺解决方案	国际领先	各类系统预驱、门驱、集驱，ClassD,DC/DC, 车灯控制，CAN/SBC 等模拟芯片

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
37	智能底盘控制马达驱动芯片研发	5,000	78.8	78.8	立项准备	开发适用汽车底盘的多款功能安全直流电机驱动芯片	国内领先	汽车底盘，EPS等应用
38	BCDU1 工艺平台研发	600	149.54	149.54	持续开发	第一代 BCDu1 工艺平台技术研发，实现高压 DEMOS 器件的开发，性能到达国内第一梯队，为各类商用、车用模拟芯片提供合适的工艺解决方案	国内领先	各类系统预驱、门驱、集驱，ClassD,DC/DC,车灯控制，CAN/SBC 等模拟芯片
39	超低成本模拟硅麦信号调理芯片，成本迭代项目	575	196.13	196.13	持续开发	低成本、高鲁棒性模拟硅麦克风信号处理 ASIC	国际领先	中低端手机、中低端 TWS
40	汽车阳光雨量传感器 SOC 项目	1,200	186.56	186.56	持续开发	研发汽车阳光/雨量 SOC 信号处理芯片，集成 LINTransceiver/符合 ISO-26262 雨量通道 ASIL-A，阳光通道 ASIL-B 设计	国内领先	汽车雨刮和环境光传感器
41	高端数字麦克风芯片项目	315	14.91	14.91	持续开发	研发高性能高鲁棒性模拟硅麦芯片	国际领先	高端 TWS 耳机和手机
42	基于隔离工艺的窄切割道预研	500	8.74	8.74	持续开发	开发基于隔离工艺的窄切割道技术，涉及晶圆前道设计，晶圆切割等新工艺研发。	国内领先	工业，泛能源，汽车电子
43	汽车电子执行器增大电流版本项目	435	15.41	15.41	持续开发	开发集成 LIN 和 LDO 以及三相半桥驱动的 BLDC 电机控制芯片	国内领先	汽车智能执行器，大功率水阀，AGS，充电小门，座椅通风
44	高精度传感器调理芯片设计	1,200	223.82	223.82	持续开发	研发符合 AEC-Q100 标准的高可靠性的传感	国际领先	汽车 TMAP，FTPS，VBS，高压喷油压

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						器调理芯片		力，机油压力， 变速箱压力
45	磁性传感器电路设计	2,300	657.93	657.93	持续开发	基于 xMR,hall 等技术研发符合 AEC-Q100 标准的车规级磁传感器芯片，支持 -24V~28V 过压反压保护，达到全温精度 1%，低功耗低噪声，支持多种输出协议类型，实现国产芯片在磁传感器领域中高端应用上的突破；其中包括磁性位移，电流，速度，开关等传感器	国内领先	工业，汽车电子，泛能源
46	麦克风专用信号数模混合处理芯片项目	595	113.59	113.59	持续开发	单端输入，双 Vdd、低功耗、高 SNR、高 AOP、PDM 接口数字硅麦克风信号处理 ASIC	国际领先	旗舰手机、中高端 TWS
47	车载超声雷达信号处理套套片项目	2,660	946.55	946.55	持续开发	研发汽车超声波雷达信号处理芯片，满足 AK2 协议/编码/功能安全 ASILB	国内领先	汽车自动驾驶市场——超声波雷达
48	新一代工控传感器 ASIC 芯片	395	19.37	189.48	量产阶段	公司第二代气缸传感器 ASIC 芯片，芯片内部集成了 LDO，AMR 感应元件，驱动，以及各种保护功能	国际领先	工业生产领域
49	新一代接近开关传感芯片	1,220	46.02	1,030.92	量产阶段	公司第一代电感式接近开关信号处理 ASIC 芯片，芯片内部集成 LC 震荡电路以及信号处理电路	国内领先	工业生产领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
50	基于电涡流原理的角度编码器芯片	1,132	59.32	1,028.75	持续开发	基于电涡流原理的新一代绝对值角度、位置传感器芯片	国际领先	机器人关节、伺服电机
51	新版线性霍尔立项开发	916	9.32	271.82	持续开发	公司第二代低功耗线性霍尔芯片，芯片内部集成了Hall感应元件，4K信号带宽，0.7mA平均功耗	国内领先	AR/VR 控制手柄、游戏手柄上的 3D 遥杆
52	天然正交双路霍尔芯片	460	25.65	289.54	量产阶段	正交双路霍尔芯片，通过 VHS 与 PHS 结合的方式该芯片可实现天然的 90°正交输出，芯片内部是 3D 的系统，支持 XYZXZY 组合	国际领先	车窗控制、座椅电机
53	具备角度计算引擎的 3D 线性霍尔传感器	1,070	33.31	192.23	持续开发	公司首款基于 VHS 与 PHS 结合的方式的 3D 线性霍尔，支持 I2C 通讯以及微功耗工作模式，并集成角度检测算法	国际领先	移动可穿戴终端
54	新一代的磁性汽车角度传感器芯片	2,025	317.43	1,559.72	持续开发	新一代的采用 IMC（集磁片）技术的磁性汽车角度传感器芯片，以满足更广泛的汽车级角度检测应用的需求。	国内领先	通用汽车角度检测应用
55	用于新能源汽车车载逆变器的高精度低温漂电流芯片	2,167	64.46	2,160.88	持续开发	公司第二代线性电流传感器芯片，电源端支持±20V 耐压保护，输出端支持 + 20V 耐压保护，灵敏度范围支持 0.5~6.5mV/Gs，1.8uS 的高速响	国内领先	车载驱动逆变器

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						应，±1.5%全温度范围灵敏度表现		
56	支持 3D-Joystick 的汽车级角度传感器	1,315	103.48	405.1	持续开发	支持 3D-Joystick 功能的 3D 角汽车级角度传感器芯片，支持 SENT，PWM，SPI 等输出，支持低功耗工作模式。	国内领先	车载电子换挡器、执行器应用
57	新一代低成本线性霍尔芯片	1,160	66.42	104.36	持续开发	公司第二代高性能线性霍尔芯片，芯片内部集成 Hall 感应元件，30K 信号带宽，2mA 平均功耗	国际领先	安防监控、智能云台
58	新一代汽车级高 ESD 霍尔传感器芯片	545	47.74	387.27	量产阶段	公司第三代车规级霍尔开关，支持 2 线以及 3 线应用，AECQGrade0 等级车规物料，高 ESD 性能	国际领先	汽车照明
59	AMR 轮速传感器芯片	2,480	55.76	2,270.43	持续开发	基于 AMR 原理的轮速传感器芯片，该芯片能检测主动轮的旋转速度，保证在广泛的速度、气隙和温度范围内提供安全的速度信息	国内领先	轮速
60	工业机器人、数控机床用高性能离轴角度传感器芯片	1,855	41.11	1,725.07	持续开发	离轴 2mm 固定磁极距增量式编码器	国内领先	工业离轴角度编码器，直线位移检测等
61	离轴双码道游标绝对值磁编芯片	1,950	26.5	92.05	持续开发	基于双码道磁环的离轴绝对值编码器芯片	国内领先	机器人关节
62	基于化合物的超高带宽电流传感器芯片	794	52.39	140.76	结束阶段	基于新能源市场应用的第一代基于化合物霍尔原理的电流 IC。使用 SOP16WA 封	国内领先	充电桩电流模块，OBC 模块，光伏逆变器

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						装。通过采用化合物技术，实现更高的灵敏度，实现超高带宽的电流传感器芯片		
63	防芯片压伤的双基岛高密度排布引线框架的研发	130	83.84	120.83	量产阶段	项目研发的新型引线框架，通过双基岛高密度矩阵排布的方式，显著提升基岛有效使用空间，进而实现芯片运算速度和芯片功能的同步提升；同时通过改变引脚、假脚布局 and 数量可达到不同产品工艺共用一套模具的目的，实现设备和人力成本的双降低	国内领先	半导体产品封装测试领域
64	半导体器高效率组装技术的研发	100	91.85	91.85	量产阶段	开发半导体器件组装设备，将上料、组装、焊接能功能组合在一台设备上，实现半导体产品的流水线式组装，组装效率大幅提升	国内领先	半导体产品封装测试领域
65	芯片测试工装等离子切割技术的研发	200	193.22	193.22	量产阶段	研发适用于芯片测试工装等离子切割的设备，增设防护罩结构，并采用环形切割技术，可有效避免切割过程产生的气体、碎屑等物质的扩散，实现无尘化生产	国内领先	半导体产品封装测试领域
66	集成电路芯片用高精度检测测试装置的研发	190	103.85	103.85	持续开发	研发适用于集成电路半导体芯片的检测测试装置，利用可调节的芯	国内领先	半导体产品封装测试领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						片定位机构,实现检测精度的提高;同时可调节的定位限位机构,能全面覆盖不同规格型号芯片外观检测的应用场景		
合计	/	216,384	53,999.21	102,028.83	/	/	/	/

注 1: 上表数据分项相加与合计项存在尾差系四舍五入所致。

注 2: 麦歌恩的本期投入为并表期间发生的研发费用, 累计投入为在研项目的实际累计投入。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

2024 年度, 公司主要从事模拟及混合信号芯片的研发和销售业务, 不存在新增业务。

十、募集资金的使用情况及是否合规

(一) 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)427 号), 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,526.60 万股, 每股发行价格为人民币 230.00 元, 募集资金总额为 581,118.00 万元; 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 22,993.34 万元(不含增值税金额)后, 募集资金净额为 558,124.66 万元, 上述资金已于 2022 年 4 月 18 日全部到位, 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了“天健验(2022)148 号”《验资报告》。募集资金到账后, 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内, 公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用和结余情况

单位: 人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	558,124.66
截至期初累计发生额	项目投入	B1	41,202.50
	利息收入净额	B2	16,716.22
	永久补充流动资金	B3	270,000.00
	用于回购股份	B4	20,010.61
本期发生额	项目投入	C1	29,781.94
	利息收入净额	C2	3,852.69
	永久补充流动资金	C3	140,000.00
	用于回购股份	C4	
	完结项目剩余资金 永久补充流动资金	C5	4,826.85
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	70,984.44
	利息收入净额	D2=B2+C2	20,568.91
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	410,000.00
	用于回购股份	D4=B4+C4	20,010.61
	完结项目剩余资金 永久补充流动资金	D5=C5	4,826.85
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4-D5	72,871.67
实际结余募集资金		F	72,871.67
差异		G=E-F	0

（二）募集资金使用是否合规

2024 年 7 月 10 日，公司经股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，但在实际执行过程中，存在使用募集资金理财产品专用结算账户永久补充流动资金的情形，但前述补充流动资金在公司审议并公告的期限及额度内进行，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，未损害公司和全体股东的利益。保荐机构已督促公司严格按照相关法律法规和公司募集资金管理制度，规范使用募集资金，避免此类情况再次发生。

除前述情形外，纳芯微 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州纳芯微电子股份有限公司募集资金管理制度》

等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接或间接持有公司股份及变动情况如下：

单位：万股

姓名/名称	与公司的关系	期初持股数量	期末持股数量	股份变动	变动原因
王升杨	实际控制人、董事长、总经理	1,876.52	1,876.52	-	-
盛云	实际控制人、董事、副总经理、研发负责人	1,704.28	1,704.28	-	-
王一峰	实际控制人、董事、副总经理	639.45	639.45	-	-
姜超尚	董事、董事会秘书	13.09	13.09	-	-
朱玲	财务总监	11.84	11.84	-	-
马绍宇	核心技术人员	37.80	37.80	-	-
赵佳	核心技术人员	37.85	37.90	0.05	二级市场自行买入
叶健	核心技术人员	37.80	38.68	0.88	股权激励归属

（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初已获授予 限制性股票数 量	报告期新授予 限制性股票数 量	报告期内可 归属数量	报告期内已 归属数量	期末已获授 予限制性股 票数量
姜超尚	董事、董事会秘 书	19,600	0	0	0	19,600
叶健	核心技术人员	54,349	0	8,788	8,788	54,349
合计		73,949	0	8,788	8,788	73,949

注 1：公司实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整，上表所列数据均为调整后的数据。

注 2：核心技术人员叶健年初已获授予限制性股票数量含 2022 年股权激励计划及 2023 年股权激励计划获授数量，其中 2022 年股权激励计划获授价格为 68 元/股（调整后）；2023 年股权激励计划获授价格为 49 元/股。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结的情形。

十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他情形

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于苏州纳芯微电子股份有限公司
2024年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



江嵘



陆佳杭

